

各位

会社名 ヒメジ理化株式会社  
(コード番号 322A TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 赤錆 充  
問合せ先 取締役 管理本部長 大槻 真  
TEL 079-336-3221  
URL <https://www.himejirika.co.jp/>

## 資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 資金借入の理由

2025年1月23日に竣工いたしました、福島県田村工場にかかる設備投資の支払を目的としております。

## 2. 借入について

借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとする協調融資団
借入金額	2,000 百万円
金利	変動金利
借入実行日	2025年2月28日(予定)
返済期限	2026年1月30日
返済方法	期日一括返済
担保	有

## 3. 今後の見通し

当社を取り巻く経営環境につきましては、地政学的リスクもあり不透明な状況にあると認識しております。

一方、半導体業界におきましては、様々なトレンドが噂される中、データセンター等を中心としたメモリー半導体の需要は回復するものと予想されます。足元では半導体市場における在庫調整局面の回復遅れにより、当社の受注環境には停滞感が見られますが、半導体デバイスメーカーでは先端半導体の製造工場の新設や増設といった今後を見据えた積極的な設備投資が相次いで計画・実行さ

れており、半導体市場は引き続き着実な拡大が見込まれていることから、当社は今後の中長期的な受注拡大の見通しを変えておりません。

本件借入による 2025 年 12 月期の業績への影響につきましては、現時点では軽微であると考えておりますが、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以上